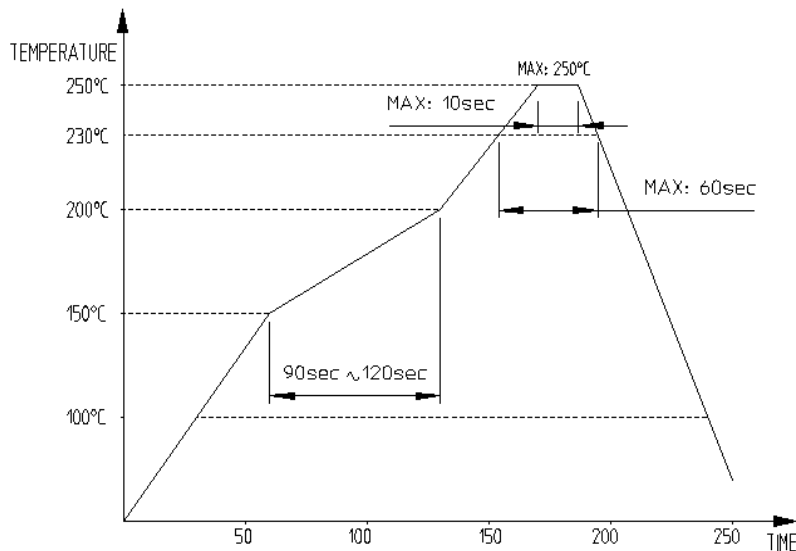


訂正	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	訂正	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
①	2	Revised	LSH	LHJ	20.01.20	③	—	Revised	KYG	LHJ	21.08.23	
②	1	Revised	LSH	LHJ	21.03.08	④	—	Revised	KYI	LHJ	21.12.16	
使用規格			Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.1 Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document Revision 2.1b									
定格	電流		1.50A Max. (電源用) (i.e. A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) 1.25A Max. VCON(i.e. B5), 0.25A (その他)									
	電圧		48V AC/DC									
使用温度範囲			-40℃ ~ +105℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)									
保存温度範囲			-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH									
Para.	項目		試験方法				規格			QT	AT	
1	外観、構造、仕上げ		EIA 364-18 目視にて確認する。				物理的な破損が無いこと。			O	O	
電氣的性能												
2	接触抵抗		EIA 364-23 100mAで20mVの最大開回路で測定します。 (DCまたは1000Hz)。 4線測定が必要であり、PCB終端の抵抗は測定値から差し引かれます。				初期 40mΩ以下 試験後、50mΩ以下			O	—	
3	耐電圧		EIA 364-20 ① 未嵌合状態でB方法で測定する。 ② AC100Vの電圧を1分間印加する。				せん絡、絶縁破壊が無いこと。			O	—	
4	絶縁抵抗		EIA 364-21 嵌合/未嵌合状態でDC 500Vで測定する。				100MΩ以上			O	—	
機械的性能												
5	挿入力		EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。				初期 & 試験後：5N ~ 20N (バージンプラグ使用)			O	—	
6	抜去力		EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。				初期：8N ~ 20N 試験後：6N ~ 20N (バージンプラグ使用)			O	—	
7	繰り返し動作		EIA 364-09 10,000回の抜き差しを行う。 -機械操作：500±50回/hr -嵌合ストローク：2.75mm -挿入、抜去力は、最大速度で測定した 12.5mm/分				物理的な破損が無いこと。			O	—	
8	ランダム振動		EIA 364-28 試験条件 VII, 試験文字 D 周波数 20-500 Hzで、 3軸方向 各15分 振動を加える。				物理的な破損が無いこと。 1us以上の電氣的瞬断がないこと。			O	—	
参 考					DRAFT M.C.PAEK 19.09.20		DESIGN M.C.PAEK 19.09.20		CHECK H.J.LEE 19.09.20		APPROVAL H.J.LEE 19.09.20	
											RELEASE DEPT 21.12.16 ENG	
NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test												
DWG NO			CL NO				PART NO					
JLC4-632573			CL 6240-0019-4-000				CX90MWP1-24P					
HRS HIROSE KOREA.CO.,LTD						製品規格表					1 3	

Para.	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能					
9	温度寿命	EIA 364-17, A方法 105℃に120時間放置する。	物理的な破損が無いこと。	O	-
10	温湿度サイクル	EIA 364-31 25℃±3℃から80%±3%RHで1時間 65℃±3℃から50%±3%RHで1時間 24サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	O	-
11	温度サイクル	EIA 364-32, 試験条件 I -55℃で+105℃10サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	O	-
12	はんだ付け性	EIA 364-52 はんだ付け部をはんだ槽245℃±5℃中に5秒間浸漬させる。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	O	-
13	塩水噴霧	EIA 364-26 濃度5%の塩水、試験温度35℃中に48時間放置する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。	O	-
14	平坦度	各ピン別のリード部の平坦度を測定する。	初期 平坦度：0.08MAX. リフロー2回後 平坦度：0.10MAX.	O	-
15	IPX4	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。 期間：少なくとも5分。 水量：10L / 分 圧力：50～150 Kpa	水漏れはありません。	O	-
16	リフローヒート	リフロー条件[図-1] ピーク250℃マックス10秒基準で2回リフローする。	絶縁座に異常ないこと。 ブリスター等の外観異常ないこと。	O	-

参 考



[Fig1]. 推奨リフロープロファイル

NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test

DWG NO	CL NO	PART NO
JLC4-632573	CL 6240-0019-4-000	CX90MWP1-24P



HIROSE KOREA.CO.,LTD

製品規格表

2

3

Qualification Test Sequence Table										
Para.	試験項目	試験グループ								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	外観、構造、仕上げ	1, 6	1, 14	1, 6	1, 6	1, 6	1, 3	1, 6	1, 4	1, 4
2	接触抵抗	3, 5	3, 13	3, 5	3, 5	3, 5		3, 5		
3	耐電圧		4, 12							
4	絶縁抵抗		5, 11							
5	挿入力		6, 10							
6	抜去力		7, 9							
7	繰返し動作		8							
8	ランダム振動	4								
9	温度寿命			4						
10	温湿度サイクル				4					
11	温度サイクル					4				
12	はんだ付け性						2			
13	塩水噴霧							4		
14	平坦度								3	
15	IPX4									3
16	リフローヒート	2	2	2	2	2		2	2	2
参 考 1)上記表の数字は各試験君別試験する順番を表示する。										
NOTE) QT : QUALIFICATION TEST, AT : ASSURANCE TEST, O : Applicable Test										
DWG NO			CL NO				PART NO			
JLC4-632573			CL 6240-0019-4-000				CX90MWP1-24P			
HRS HIROSE KOREA.CO.,LTD					製品規格表					3 3